

超砥粒使用 ディスクグラインダー専用バリ取り砥石

◎ 用途 SUS304, SPCCなどのレーザーカット、シャーリング切断後のバリ取り

◎ 特徴

SPCC

2次バリが
ほとんど出ない

SUS304

面取り部も
きれいな仕上げ

下地付きの砥粒層だから
ワークを傷めません



下地の色が見えたら
交換してください

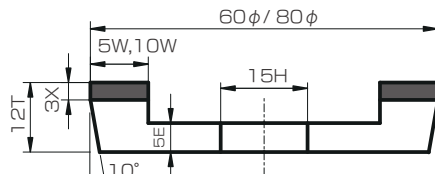
軽くなでるだけ
一発で除去

目詰りしにくい
表面仕上げ

◎ 形状

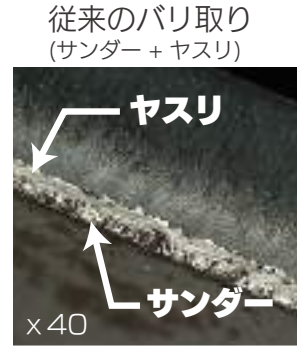
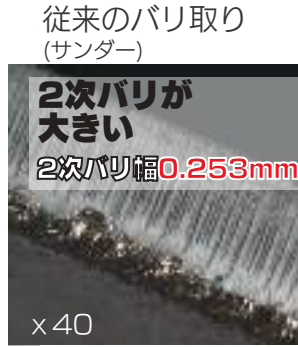
- 60φ × 5W,10W × 3X
- 80φ × 5W,10W × 3X

ソフトタイプとハードタイプからお選びください。



◎ ご使用に際して

- 使用者は防塵メガネ、安全靴、保護帽の保護具を着用し、作業に適した裾とそで口のしまっている作業着を着用して下さい。
- 下地が見えてきたら交換をおすすめします。



made in Japan